



# 114年第三季財務資訊法人說明會

114/12/11

1

致歡迎詞

2

公司簡介

3

114第三季財務資訊

4

AI 驅動\_伺服器成為 ODM 廠成長核心動能 vs 威健機會

5

114 公司主要 Focus市場與產品線機會

6

企業價值計畫資訊

7

公司治理及企業社會責任辦理情形

8

Q & A

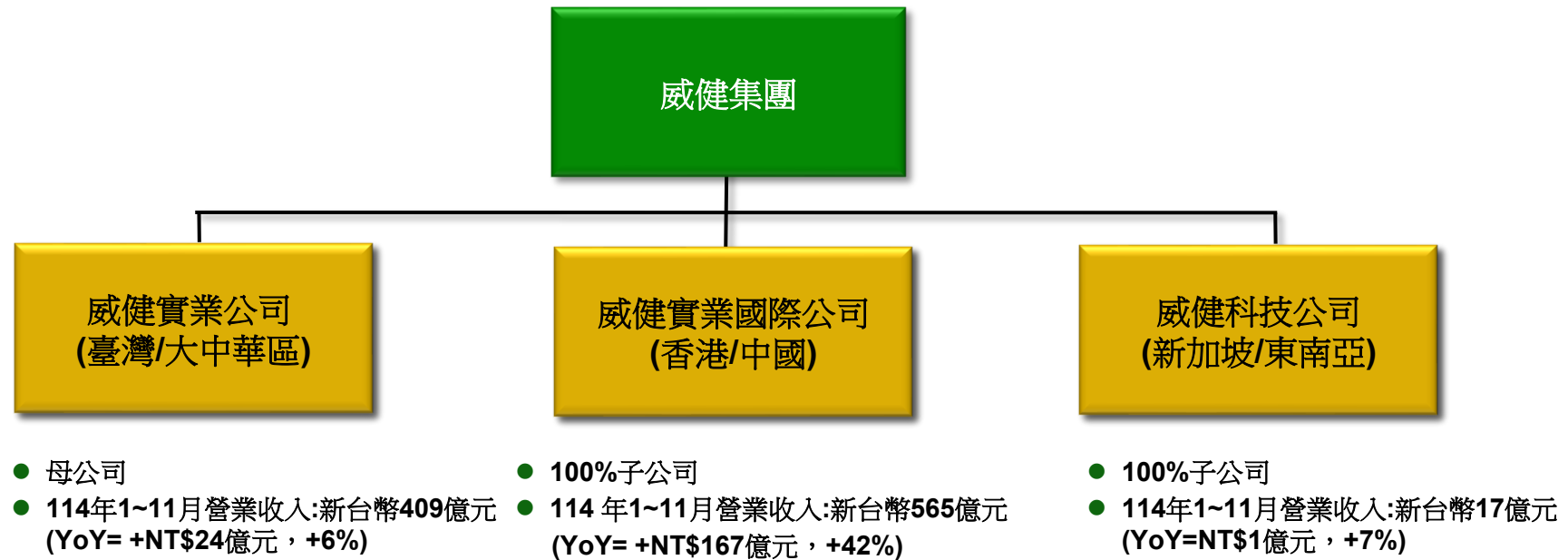
本公司聲明對目前預期所作之前瞻性陳述，須受重大風險和不確定性因素之限制，其實際結果可能與前瞻性陳述中的含義大不相同。

關於可能導致實際結果發生變化的因素訊息，可以在本公司向台灣證券交易所（TWSE）提交的季度或年度財務報告，以及本公司不定時發布於TWSE的股市觀測站重大訊息查閱。

除法律規定者外，無論是由於新訊息，未來事件或其他原因，本公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

此外，本報告所載示之財務資料訊息係遵照國際財務報導準則(IFRSs)編制。

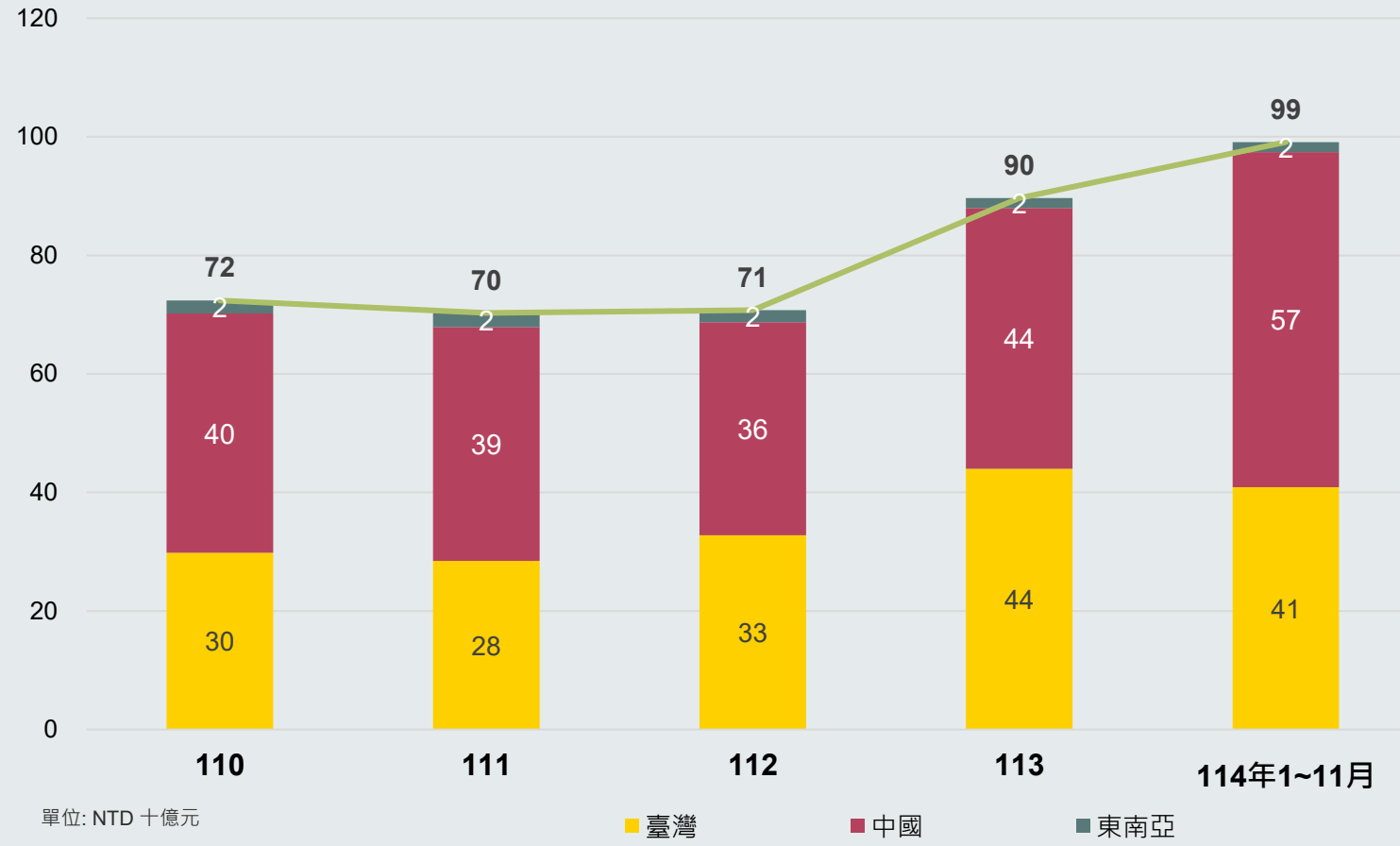
- 114 年1~11月集團合併淨營業收入新台幣991億元(自結數) (YoY= +24%)



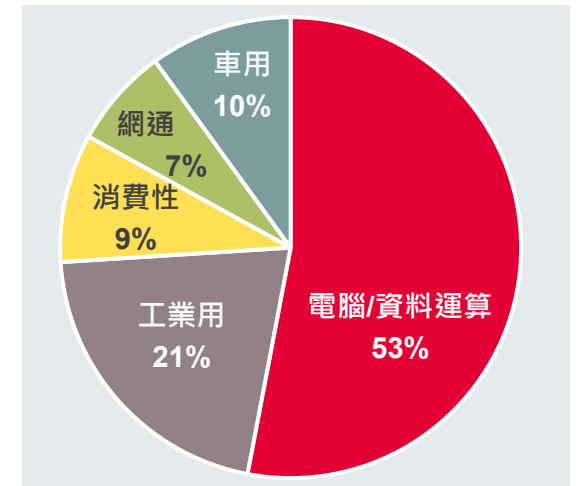
# 公司簡介 – 營業收入, 110~114/1~11月



集團營業收入, 110-114/1~11月



114年1~11月



# 前三季財務資訊\_合併綜合損益表



合併綜合損益表選定項目(單位:新台幣佰萬元)	114年 第三季	114年 前三季 累積	114年 第二季	113年 前三季 累積	114年第三季與 上季比較 (QoQ)	114年前三季累積 與去年同期比較 (YoY)
淨營業收入	26,427	80,696	28,460	64,992	-7%	24%
營業毛利	1,351 5.11%	3,188 3.95%	460 1.62%	3,783 5.82%	194% +3.49百分點	-16% -1.87百分點
營業費用*	727	2,059	636	1,906	14%	8%
營業淨利	624 2.36%	1,129 1.40%	(176) -0.62%	1,877 2.89%	453% +2.98百分點	-40% -1.49百分點
營業外收支淨額**	(176)	(418)	2	(756)	-8525%	45%
稅前淨利	447 1.69%	711 0.88%	(174) -0.61%	1,120 1.72%	357% +2.32百分點	-37% -0.84百分點
本期淨利	329	490	(162)	877	303%	-44%
基本每股盈餘(新台幣元)	0.69	1.03	(0.34)	2.00	303%	-49%
平均匯率 (美元/新台幣)	29.93	31.23	30.90	32.03	-3%	-2%

\*114年前三季員工持股信託勞務成本1,516萬+員工認股權勞務成本2,167萬，合計3,683萬

\*\*第三季上期比較：  
1.財務成本減少NT\$25佰萬元  
2.本期兌換利益淨額減少NT\$1.86億元  
\*\*前三季同期比較：  
1.利息收入增加NT\$10佰萬元  
2.財務成本減少NT\$35佰萬元  
3.本期兌換利益淨額增加NT\$3.3億元

# 財務資訊\_資產負債表及財務重要指標



資產負債表選定科目 (單位:新臺幣佰萬元)	114年9月底		113年12月底		113年9月底	
	\$	%	\$	%	\$	%
現金及約當現金	3,966	9	2,985	7	2,080	5
應收票據及帳款淨額	18,207	43	17,745	42	16,685	43
存貨淨額	18,164	43	20,525	48	18,737	48
<b>資產總計</b>	<b>42,060</b>	<b>100</b>	<b>42,831</b>	<b>100</b>	<b>39,116</b>	<b>100</b>
短期借款	17,329	41	17,341	41	14,844	38
應付票據及帳款	8,621	20	8,277	19	8,133	21
<b>負債總計</b>	<b>31,916</b>	<b>76</b>	<b>31,916</b>	<b>74</b>	<b>28,980</b>	<b>74</b>
<b>權益總計</b>	<b>10,144</b>	<b>24</b>	<b>10,915</b>	<b>26</b>	<b>10,136</b>	<b>26</b>
<b>重要財務指標</b>						
應收帳款收款天數	61		64		64	
存貨週轉天數	68		89		88	
應付帳款付款天數	30		39		40	
流動比率 (倍)	1.45		1.47		1.49	
營運資金報酬率(%)	5.21		9.27		9.66	
股東權益報酬率(%)	6.20		11.60		12.37	
期末匯率	30.515		32.725		31.69	



# AI 驅動\_伺服器成為 ODM 廠成長核心動能 vs 威健機會



- ◆ 主要伺服器 ODM廠，AI 伺服器已成為營收與成長的主要驅動力：
  - AI 伺服器營收規模已突破兆元等級，且 2025 年仍快速成長
  - AI 伺服器營收占比普遍達 **40%–80%+**，結構性高於傳統伺服器
  - AI 訂單能見度延伸至 **2026–2027 年**，產業可見性明顯提升
  - 驅動資料中心向 800V高壓直流（HVDC）架構與光通訊 OCS,CPO 發展
- ◆ 威健機會
  - AI 伺服器提升「單台 BOM 價值」，有助**產品深度**
    - ✓ 電源管理IC與功率半導體
    - ✓ 高速互連與光通訊(OCS,CPO)
    - ✓ 記憶體
  - 供應與系統解決方案協作者-FAE 深度支援與跨產品線整合能力
  - TPU ASIC多元化，客戶與平台更加分散
    - ✓ 在多雲、多平台中持續努力取得 **design-in** 機會，降低對單一晶片平台或單一原廠之依賴

AI 伺服器功能模組	代理原廠-產品線	平台與應用機會	營收%
			2025
運算核心平台_CPU, GPU	AMD,Molex	AMD Platform, CSP ASIC GPU	9.1%
運算板卡／GPU 模組／主板_Compute Board (HPM, SCM), GPU Module, GPU Base Board	Lattice, Microchip, Molex	Nvidia: HGX, MGX, DGX, GB200, GB300 AMD Platform CSP ASIC	
電源系統與備援模組_Power shelf, PSU, BBU, HVDC, PDB Board	Infineon, Vishay, Microchip		
高速網路與互連_Ethernet Switch, Nvlink Switch, NIC	Lattice, Infineon, Vishay, Microchip, Molex		
記憶體與儲存_Memory (DRAM, NOR, NAND, SSD, eMMC, UFS, HDD)	WD, Sandisk, GigaDevice, Infineon		



# 114 公司主要 Focus市場與產品線機會

Market Segment	公司相關產品線	目前市場情況	2025 Market (unit) YoY(F)	2025 Weikeng(\$) YoY & 營收%
Server (General, AI)	Infineon, AMD, Molex, Lattice, Microchip, Vishay, WD/SanDisk	<ul style="list-style-type: none"> <li>AI-server 將持續是 server 市場的主動力。2026 年 AI-server 出貨年增可超過 20%(TrendForce)。</li> <li>雖然 AI-server 占比提升，但一般用途 server ( general-purpose server ) 仍有穩定市場，特別是企業、政府、edge / on-premise 應用仍會維持一定需求</li> <li>兼顧通用 server 與 AI-server 雙軌市場</li> </ul>	3.7%	18.3% / 15.2%
PC (DT, NB), AI PC	AMD, Infineon, Molex, Vishay, WD/SanDisk, Amazing, GigaDevice, Sinopower, Lattice	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業換機潮：Windows 10 退役，企業、政府、教育端需求上升。</li> <li>邊緣AI ( Edge AI ) 趨勢：AI運算下壓至終端PC / NB，帶動具 NPU / dGPU 的產品需求。</li> <li>消費升級與隱私需求：企業與專業用戶願意為邊緣 AI 能力支付溢價。</li> <li>零組件供應結構：高階記憶體與加速器搶購可能造成短期缺口，對整機成本形成壓力。</li> </ul>	3.8%	38.8% / 32.7%
Automotive	Infineon, NXP, Molex, Lattice, Microchip, Vishay, WD/SanDisk	<ul style="list-style-type: none"> <li>電力電子快速成長 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓SiC、IGBT、車用 MOSFET 在電動車與快充架構中滲透率提升</li> </ul> </li> <li>ADAS / 車用 AI 解決方案需求提升 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓智慧座艙、輔助駕駛推升 AI SoC、Sensor、Memory 與相關電源 IC 需求</li> </ul> </li> <li>MCU 與車用記憶體的長期穩定需求 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓車用電子模組普及，使 MCU / Flash / DRAM 成為基礎配置</li> </ul> </li> </ul>	Global New Vehicle: 3.4% Global New EV: 17% CN New Vehicle:3% CN New EV:20%	54.4% / 7.5%
Robotics	Infineon, NXP, Molex, Lattice, Microchip, Vishay, WD/SanDisk	<ul style="list-style-type: none"> <li>2025 年被視為 市場持續擴張、從「早期採用 / 工業導入」進入「多面向應用」的轉換關鍵年</li> <li>中國在 2024-2025 年為全球最大安裝市場，且機器人對半導體需求快速成長</li> <li>關鍵技術驅動：邊緣AI ( AI 加速器/SoC/MCU )、機器視覺 ( 影像感測 + AI 推論 )、高效電機驅動 / 馬達控制器、力覺/力矩感測、功率管理 ( PMIC、電源供應 ) 等成為 BOM 中的高價值模組</li> </ul>	6%-7%	109.9% / 0.4%
New Energy	Infineon, Vishay, Microchip, NXP	<ul style="list-style-type: none"> <li>電動車與新能源車已經不是「小眾 / 政策主導」市場，而是主流市場 — 對汽車零組件、電池、充電基礎設施、電力管理系統、半導體/IC、電力電子等供應鏈極具吸引力</li> <li>電力電子 / 半導體需求大增：隨著新能源發電轉型 ( 風 / 光 / 儲能 ) + 電動車普及，對功率半導體、電池管理 IC、電力轉換模組、儲能控制器等元件需求會明顯上</li> <li>汽車零組件 &amp; EV 供應鏈參與：新能源車與混合車的普及意味著更多汽車電子、電池管理、車用半導體、電動機控制系統等需求</li> <li>儲能 / 能源管理系統 ( EMS )：需要大量IC、控制板、儲能電池模組</li> </ul>	7%-8%	17.3% / 1.2%

- ◆ 本公司依據上市上櫃公司治理實務守則，為持續提升公司治理、促進與利害關係人溝通，進而提升國際競爭力，創造長期價值，經董事會於114.11.14核定通過『提升企業價值計畫』。

- ◆ 現況分析

- 資金結構與成本：

- 截至114年6月底止，本公司資金結構依市值衡量係由36%權益和64%債務組成，公司的權益成本(Cost of Equity)約為 10.48%，債務成本(Cost of Debts)約為3.71%，加權平均資金成本WACC為5.66%，略低於同業平均（同業3.93%~8.3%）6.07%，位於同業中位數，資金結構尚屬均衡，能抵禦市場波動。

- 獲利能力：

- 本公司近四季(113年下半年~114 年上半年)ROIC 達 5.83%，略低於同業平均6.43%（同業 1.72%~9.76%），顯示本公司資金使用效率仍有進步空間，而本公司 ROIC 高於 WACC，代表目前的資本運用仍能夠創造正向價值；ROE 7.48%（高於同業平均），資本運用有效。

- 市場評價：

- PBR 1.48 倍(114.11.3收盤價核算)，低於同業平均，受國際政經與匯率影響，獲利成長被受限。

- 潛在成長評估：

- ✓ 儘管國際情勢動盪，本公司於 114 年第 3 季合併營收年增率達 24.16%，近四季營收年增率更高達 32.28%，展現強勁業務擴張力。
    - ✓ 若庫存壓力逐步解除，且美國聯準會啟動降息循環，將有助於降低財務成本、提升獲利能力。
    - ✓ 公司將持續強化通路整合、提升營運效率，並積極開拓新興應用領域，以因應全球市場變局與產業結構調整，創造未來成長動能。
    - ✓ 俟匯率平穩後，將可消弭影響獲利不穩定因子，進以提升獲利。

- ◆ 請參閱本公司官網<https://www.weikeng.com.tw/content.php?no=53>

- ◆ 本公司規劃以資本額超過 50 億元之標準，將於 117 年揭露 116 年依據 IFRS 第 S1 號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及第 S2 號「氣候相關揭露」相關永續資訊，由 KPMG 輔導。
- ◆ 本公司自 113 年起進行母公司組織型溫室氣體盤查是採用 ISO 14064-1 架構進行，已由BSI台灣分公司完成驗證；114 年集團合併報表對象進行盤查亦是採用 ISO 架構，亦將於115第一季委請BSI進行驗證。
- ◆ 主管機關為與國際接軌，對於 IFRS S2 溫室氣體排放資訊，要求上市公司採 GHG Protocol 架構進行溫室氣體盤查，因此，公司將面臨資訊收集平台轉換問題，目前已與成創永續公司進行溝通及掌握相關轉換問題，轉換時點應是在 116 年，以接軌 117 年揭露 116 年 IFRS 永續資訊。
- ◆ 基層員工薪酬福利：稅前淨利 6%~10% 作為員工酬勞，至少 7% 分配給基層員工(全時工時員工之月平均經常性薪資114年度NT6.3萬元；115年度6.5萬元)，範圍定期評估並納入內控制度與稽核。
- ◆ 為提升公司在國際貿易供應鏈中的競爭力，並促進與客戶、原廠夥伴的合作機會，本公司已將『安全認證優質企業 (AEOS)』認證列入 114 年度之計畫，以訴求跨境貨物移動安全的認證，獲得認證後將可提升全球貿易的安全與便捷，並享有快速通關的優惠措施，本計畫之執行已於114.11.28向財政部關務署基隆關正式申請，未來將擇日蒞臨本公司實地審查。
- ◆ 為響應公司治理評鑑指標促進社區發展等議題、ESG-Social 議題(社區參與 關懷、員工健康)以及聯合國永續發展目標Sustainable Development Goals (指標SDG3 健康與福祉、SDG4優質教育、SDG8 合適的工作及經濟成長、SDG14保育海洋生態以及SDG15陸域生態、SDG17永續發展夥伴關係)，本公司截至114年第三季，已實踐或已安排之公益活動，請參閱本公司官網<https://www.weikeng.com.tw/content.php?no=50> 社區參與及社會公益執行情形。
- ◆ 本公司已陸續取得之ISO認證如下

ISO45001:2018 ( 職業安全衛生管理系統 )
ISO9001:2015 ( 倉儲服務 )
ISO 14064-1:2018 ( 溫室氣體排放 )
ISO/IEC 27001:2022 ( 資訊安全管理系統 )

**Q & A**

A close-up photograph of two hands shaking in a firm grip. The hand on the left is wearing a dark blue suit jacket with three buttons visible. The hand on the right is wearing a dark blue long-sleeved shirt. The background is a plain, light grey.

**Your Best Partner**